

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2024-032

芯原微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1537号）以及上海证券交易所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2020]261号），芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“芯原股份”）已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）48,319,289股，每股发行价格为38.53元，募集资金总额为186,174.22万元，扣除发行费用18,378.91万元后，募集资金净额为167,795.31万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月13日出具《验资报告》（天职业字[2020]32075号）。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2024年1-6月募投项目实际使用募集资金53,247,834.78元，2024年1-6月收到的募集资金利息收入扣减手续费净额523,461.12元；截至2024年6月30日，公司募集资金余额为7,553,502.67元，均存储于募集资金专户。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	1,699,030,248.80
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	228,863,054.51
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额	21,077,171.28
减：以超募资金永久补充流动资金金额	535,678,253.04
减：累计至 2024 年 6 月 30 日募投项目实际支出金额	944,441,710.91
减：截至 2024 年 6 月 30 日用于现金管理金额	20,000,000.00
减：补充流动资金（募投项目结余转出）	9,464,377.81
加：累计至 2024 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣减手续费净额	68,047,821.42
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	7,553,502.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，制定了《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该管理办法已经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司及子公司芯原科技（上海）有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“开户行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司因部分募投项目募集资金使用完毕对相关募集资金专户进行销户，具体情况详见本报告“二（三）募集资金专户存储情况”。

尚未注销的募集资金专户监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	截至2024年6月30日账户余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600002036	-	销户中 (注 1)
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03004198987	-	已销户
中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行	1001235929300088184	-	销户中 (注 2)
中信银行股份有限公司上海分行张江支行	8110201013701212254	-	已销户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910739810105	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003720	7,553,502.67	
总计	/	7,553,502.67	

注 1：该账户为公司超募资金的募集资金专户，截止 2024 年 6 月 30 日，该账户内的超募资金已使用完毕并进入销户流程，该账户已于 2024 年 7 月 17 日完成销户。

注 2：该账户为公司“智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目”的募集资金专户，该项目已于报告期内完成，结余募集资金（包括利息收入）192.96 万元已全额结转补充流动资金。目前，该项目已进入销户流程。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024 年 1-6 月，本公司实际投入的募集资金款项共计人民币 53,247,834.78 元，募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。2024年3月29日召开了第二届董事会第十三次会议暨2023年年度董事会、第二届监事会第十二次会议暨2023年年度监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会/股东大会（视届时审批权限）审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币5,000.00万元（含本数）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：人民币万元

银行名称	产品类别	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回	期限(天)	收益
浦发银行	结构性存款	2,000.00	2024/4/7	2024/7/8	2.55%	否	91	12.04

截至2024年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为2,000.00万元，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

（三）使用超募资金永久补充流动资金情况

结合公司2024年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十三次会议暨2023年年度董事会、第二届监事会第十二次会议暨2023年年度监事会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余的全部超额募集资金465.92万元（预计转出包括利息及现金管理收益等在内的全部结存余额，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金。保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。上述事项已经

公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。截止 2024 年 6 月 30 日，公司已完成使用上述超募资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金金额为 467.83 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2024 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2024 年 1-6 月，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		1,677,953,077.52				本年度投入募集资金总额			53,247,834.78			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			1,708,983,018.46			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额②	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 ③=②-①	截至期末 投入进度 （%） ④=②/①	项目达到 预定可 使用状 态日期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
一、承诺投资项目												
智慧汽车的 IP 应用方	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	1,014,644.58	151,131,473.56	1,131,473.56	100.75	2024	不	不	否

案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目									年	适用	适用	
智慧家居和智慧城市的IP应用方案和芯片定制平台项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	113,486,346.90	3,486,346.90	103.17	2022年	不适用	不适用	否
智慧可穿戴设备的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	111,664,603.67	1,664,603.67	101.51	2022年	不适用	不适用	否
智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	118,967,830.18	-1,032,169.82	99.14	2022年	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	308,327,829.51	8,327,829.51	102.78	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	1,014,644.58	803,578,083.82	13,578,083.82	101.72	-			
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	否	535,678,253.04	535,678,253.04	535,678,253.04	4,678,253.04	535,678,253.04	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	47,554,937.16	369,726,681.60	-20,273,318.40	94.80	2024年	不适用	不适用	否

超募资金小计	-	925,678,253.04	925,678,253.04	925,678,253.04	52,233,190.20	905,404,934.64	-20,273,318.40	97.81	-			
合计（注）	-	1,715,678,253.04	1,715,678,253.04	1,715,678,253.04	53,247,834.78	1,708,983,018.46	-6,695,234.58	99.61	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三、（二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”相关内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告之“三、（三）使用超募资金永久补充流动资金情况”相关内容。											
募集资金结余的金额及形成原因	基于智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目的实施安排，上述项目已于报告期内完成，结余募集资金（包括利息收入）192.96 万元已全额结转补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。